



中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 10416—93

半导体分立器件芯片总规范

**Generic Apecification for chip for
semiconductor discrete devices**

1993-12-17 发布

1994-06-01 实施

中华人民共和国电子工业部 发 布

中华人民共和国电子行业标准

半导体分立器件芯片总规范

SJ/T 10416—93

Generic Apacification for chip for
semiconductor discrete devices

1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体分立器件芯片(以下简称“芯片”)的技术要求、检验方法及验收规则。
本标准适用于半导体分立器件芯片,含已粘膜划片的大圆片和未划片的大圆片。单个管芯也可参照使用。

2 引用标准

GB 191	包装储运图示标志
GB 4589.1	半导体器件 分立器件和集成电路总规范
GB 4937	半导体分立器件机械和气候试验方法
GB 4938	半导体分立器件接收和可靠性
GB 12962	硅单晶
GB 12964	硅单晶抛光片
GJB 128	半导体分立器件试验方法

3 术语

3.1 挡比 range ratio

符合芯片详细规范规定的电参数某挡的数量与所提交总数的百分比。

4 质量一致性检验

4.1 检验批的构成

一个检验批可由一个生产批组成,或者在下述情况下由几个生产批组成:

- 这些生产批是在相同条件下(生产线、工艺、材料等)制造出来的。
- 每个生产批的检验结果表明,材料和工序质量能保持生产的产品符合规范要求;
- 集合成一个检验批的周期一般不得超过一周。除非另有规定,但也不得超过一个月。

4.2 凡本章中采用的“规定”或“按规定”一词,未引让出处时,即指引证芯片详细规范。

4.3 A组检验(逐批)

A组检验由列于表1的6个分组构成,主要检验芯片的图形、尺寸、外观质量、键合强度、